证券代码：688584 证券简称：上海合晶

**上海合晶硅材料股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

 编号：2025-003

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | 🗹特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动🗹现场参观 □电话会议□其他 |
| 会议主题 | 走进郑州合晶调研暨公司近况交流会 |
| 参与单位名称 | 共9家机构，参会机构名单详见附表 |
| 时间 | 2025年10月17日 |
| 地点 | 郑州 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长 毛瑞源郑州合晶 董事长、总经理 钟佑生董事会秘书 庄子祊财务总监 方时彬 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **问题1：公司目前以及未来的产品布局规划是什么？****答复：**目前，上海合晶主要有三个厂，扬州合晶生产6英寸和8英寸的晶棒；上海晶盟生产6英寸、8英寸、12英寸外延片；郑州合晶负责8、12英寸的长晶、切磨、抛光等一体化环节。公司短期目标是到明年底12英寸产能达到10万片/月，4万片/月POWER用外延片，6万片/月CIS用外延片。同时，公司正在进行逻辑用P/P-28nm用外延片的研发送样，长期规划未来实现10万片/月P/P-用外延片量产。公司当前产能规划是：12英寸外延片产能目前4万片/月，主要用在POWER；预计郑州二期新增6万片/月12英寸外延片，主要用在CIS，今年年底小部分量产，明年一季度、二季度逐步增加，明年年底落实。公司长远规划还有郑州三期，未来再增加10万片/月P/P-用外延片量产。**问题2：和国内比较内卷的竞争对手相比，公司有哪些优势值得关注？****答复：**公司的产品具备差异化优势。在8英寸产品领域，公司通过重点推进8英寸超（极）重掺长晶研发、8英寸多层梯度外延工艺研发、8英寸超阻值均匀性超厚外延工艺研发等项目，目标成为标杆。在12英寸领域，公司聚焦高端产品，如55nmCIS和28nmLOGIC。此外，上海合晶是全世界最早一批进入POWER领域的，未来将聚焦高端POWER领域，同时借助POWER和国际大厂的合作经验加速导入高端CIS领域，未来希望应用于5000万像素的手机用CIS和车规级CIS。公司的客户资源较为优质。公司向全球前十大晶圆代工厂中的7家以及全球前10大功率器件IDM厂中的6家公司供货，如华虹宏力、芯联集成、华润微、台积电、力积电、安森美等。和大多数国内同业不同，上海合晶采取分步建设策略。公司采用迭代发展的模式，从4英寸到6英寸、8英寸再到12英寸，从POWER用到CIS用到P/P-用，逐步扩大产能。这种分步建设的策略避免了重资本投入带来的风险，同时有利于经验的积累和技术的提升。**问题3：在公司扩产的过程中，如何处理折旧方面的压力？****答复：**折旧压力一定存在，公司以8寸支持12寸，12寸线分步扩产。上海晶盟和郑州合晶一期折旧压力比较小，我们靠着旧厂获利支持12寸的发展。此外，12寸线分三期扩产，一期4万片/月POWER用，二期明年年底建成6万片/月CIS模拟芯片用，未来再建10万片/月P/P-逻辑用，分步扩产使投入和财务压力相对较低。**问题4：公司的毛利率和同行相比有明显的差异，请问原因是什么？****答复：**公司采取差异化竞争的产品策略，具有20年以上的技术、高质量产品和优质客户积累，避免卷入国内的内卷市场，以维持公司的稳定获利。 |
| 关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明 | 不涉及。 |
| 附件清单（如有） |  |

|  |
| --- |
| **附表：参会机构名单（排名不分先后）** |
| 序号 | 机构名称 |
| 1 | 中信证券股份有限公司 |
| 2 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 3 | 中邮证券有限责任公司 |
| 4 | 国金证券股份有限公司 |
| 5 | 东北证券股份有限公司 |
| 6 | 华安证券股份有限公司 |
| 7 | 青骊投资管理（上海）有限公司 |
| 8 | 上海汐泰投资管理有限公司 |
| 9 | 北京金九瑞和私募基金管理有限公司 |